



平成 25年11月13日

各 位

会 社 名 株式会社日本マイクロニクス
代 表 者 名 代表取締役社長 長谷川正義
(JASDAQ・コード6871)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 齋藤 太
T E L 0 4 2 2 - 2 1 - 2 6 6 5

フリップチップ用 MEMS プローブカードの量産開始のお知らせ

当社はこの度、フリップチップ実装デバイスの多数個同時測定対応プローブカードとして開発した「MEMS-SP」の量産対応の準備が整いましたので、お知らせいたします。

記

1. 開発・製品化の背景、概要

スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、これらに搭載されるフリップチップ実装デバイス（マイクロプロセッサや SoC など）の需要が旺盛となっています。また、このフリップチップ実装デバイスは今後更に高速化・高密度化し、接続端子はソルダーバンプから Cu ピラーやマイクロバンプへと置き換わることで、フリップチップ市場は益々拡大していくと予想されます。

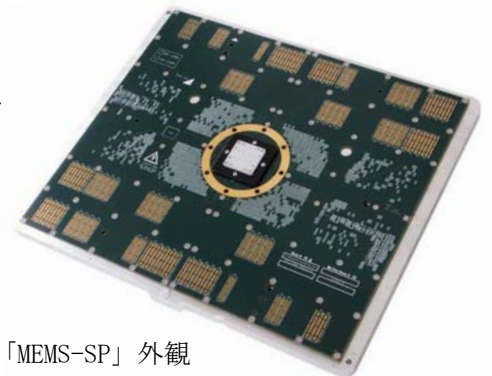
当社はこれに対し、デバイスの高速化、高密度化およびウェーハ多数個同時測定の需要に応えるべく、MEMS プローブカードの開発を行い、大手デバイスメーカー数社における評価と量産化の準備を進めておりました。

2. 主な特長

- (1) フォトリソグラフィ技術で製造した三次元螺旋形状のパレルー一体型スプリング
- (2) 自由度の高いスプリング形状により、ストローク・針圧のカスタマイズ化を実現
- (3) コンタクト媒体に合わせたプローブ先端の材質および形状のカスタマイズが可能
- (4) プローブは1本より交換可能、オンサイトでも特別な設備を要せず作業可能

3. 主な仕様

- | | |
|----------------|---------------------------|
| (1) プローブカードタイプ | 垂直型 MEMS プローブ |
| (2) 最大 Pin 数 | 30,000 Pin |
| (3) 最小ピッチ | 100 μ m |
| (4) Pad レイアウト | フル・グリッド |
| (5) 対応温度 | $\leq 90^{\circ}\text{C}$ |



「MEMS-SP」外観

4. 今後の計画

2014年にピッチ80 μ m および高温 $\geq 150^{\circ}\text{C}$ 対応などのプローブをリリース予定です。

製品に関するお問合せ先
プローブカード事業部 営業統括部
TEL 0422-21-0115

以 上